

Consolidated Business Results & Forecasts

2023年3月期 決算説明会

2023年5月10日

株式会社SCREENホールディングス

内容：

- ・ 2023年3月期 連結決算の概要 専務取締役（CFO） 近藤 洋一
- ・ 事業環境および業績予想 代表取締役 取締役社長（CEO） 廣江 敏朗

資料取り扱い上の注意

- ・ 本資料および口頭にて提供する業績予想は、当社が発表日現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績などは様々な要因により大きく異なる可能性があります。
- ・ 本資料に記載しております数字につきましては、単位未満切り捨てで処理しております。比率は四捨五入しております。
- ・ 本資料では、例えば、「FY2023/03」と示す場合、2022年4月1日～2023年3月31日の会計期間を表します。

2023年3月期 連結決算の概要

2023年5月10日

株式会社SCREENホールディングス
専務取締役 最高財務責任者 (CFO)

近藤 洋一

2023年3月期実績

- 全社>>
 - ・ 前期比増収増益、売上、利益ともに過去最高
 - 1月予想比、売上、利益ともに上振れ
 - 前期比、売上高は11.9%増加、営業利益は24.8%増加
- SPE>>
 - ・ 前期比増収増益、売上、営業利益ともに過去最高
 - 営業利益率は20.7%
- GA、PE：1月予想比、売上、営業利益ともに上振れ
- 1株当たり365円に増配（過去最高、前期実績1株当たり293円）

FY2023/03 連結業績

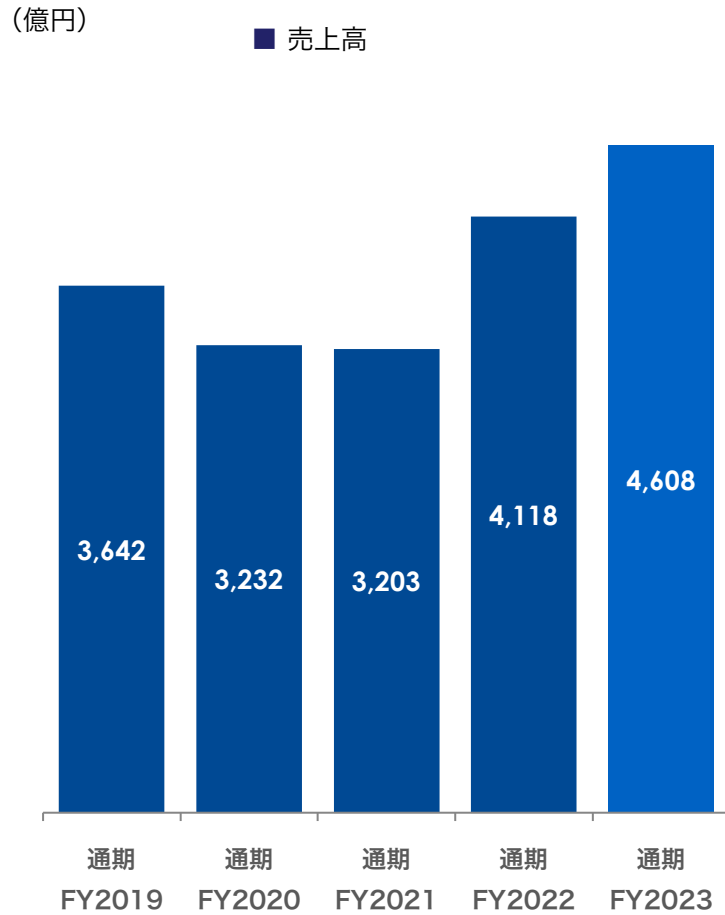
四半期

通期

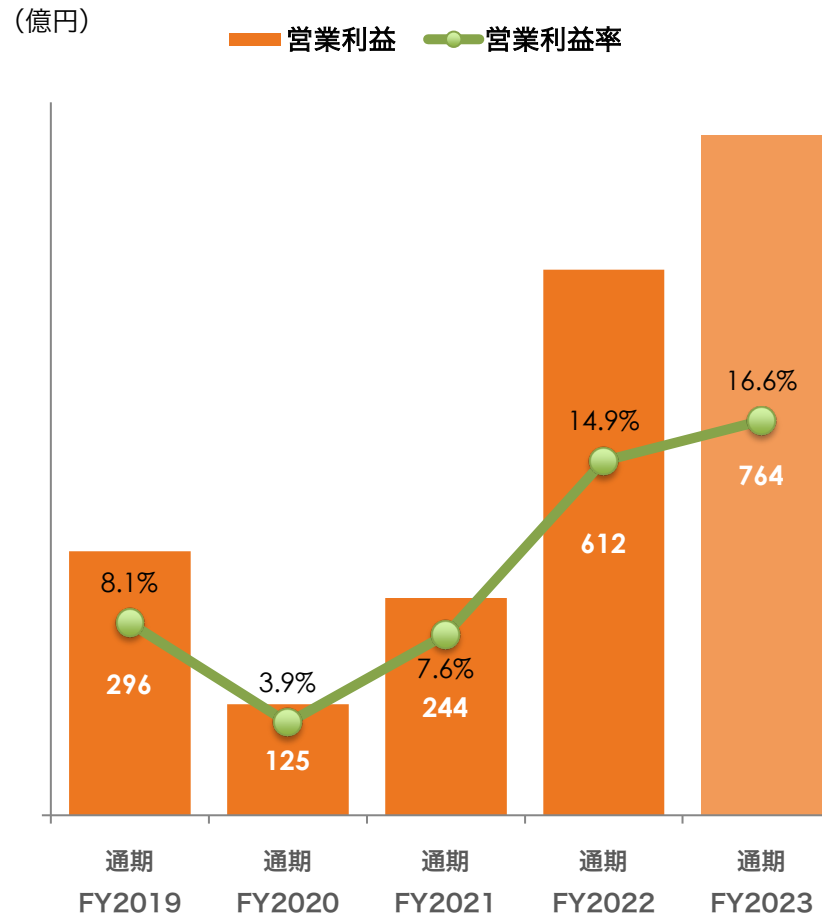
	FY2022/03				FY2023/03					FY2022/03		FY2023/03					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	前期比		通期	通期	前期比				
(億円)																	
売上高	828	1,043	1,039	1,207	1,018	1,165	1,168	1,255	87	7.5%	4,118	4,608	489	11.9%			
営業利益 営業利益率	86 10.5%	153 14.7%	160 15.5%	211 17.5%	178 17.5%	203 17.4%	184 15.8%	197 15.8%	13	7.1% -0.1pt	612 14.9%	764 16.6%	151	24.8% 1.7pt			
経常利益	86	151	161	195	182	204	185	201	16	9.2%	594	773	179	30.2%			
親会社株主に帰属する 当期純利益	60	115	120	158	160	135	121	156	34	28.8%	454	574	120	26.4%			

連結決算の概要

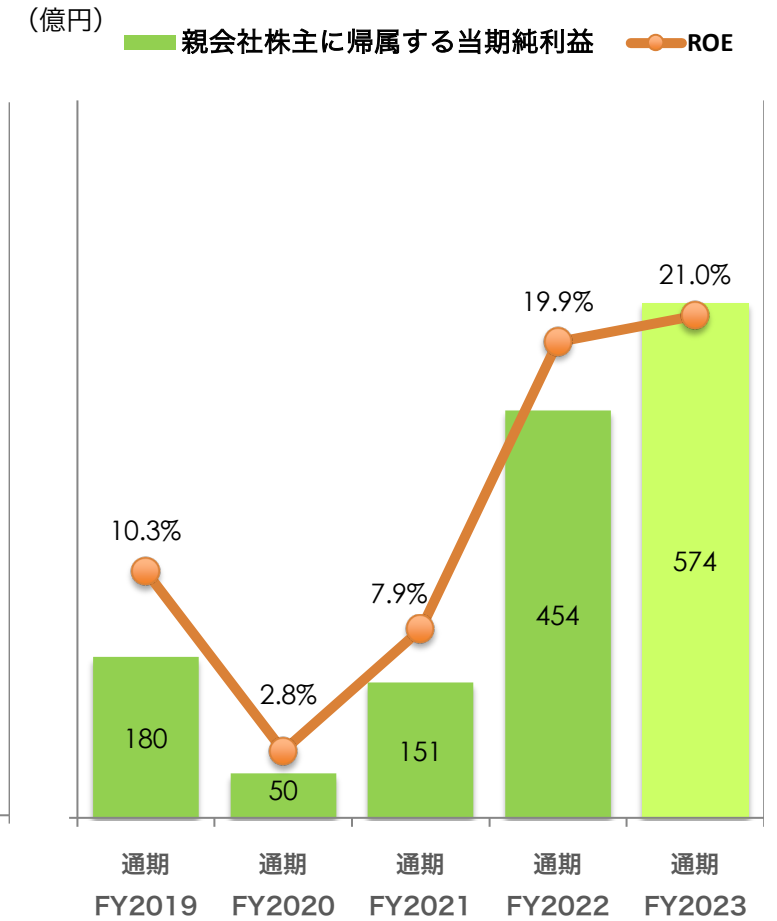
売上高



営業利益と営業利益率

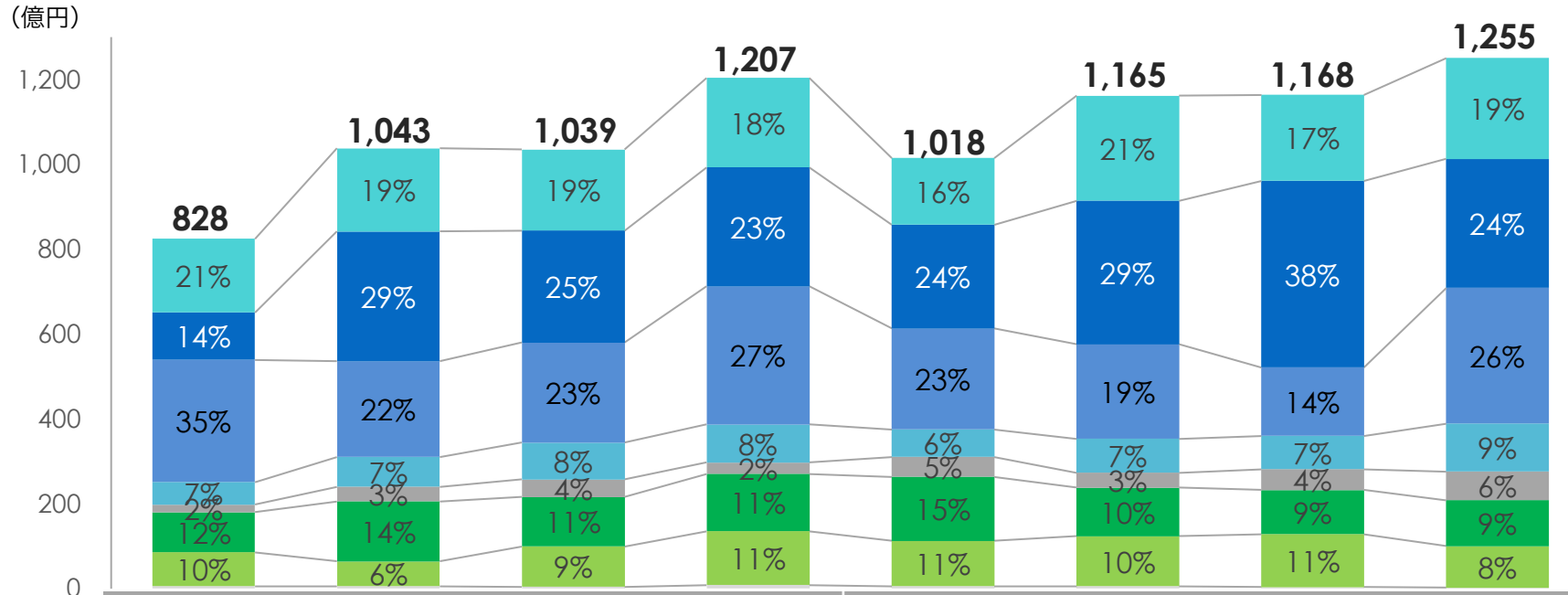


親会社株主に帰属する当期純利益とROE



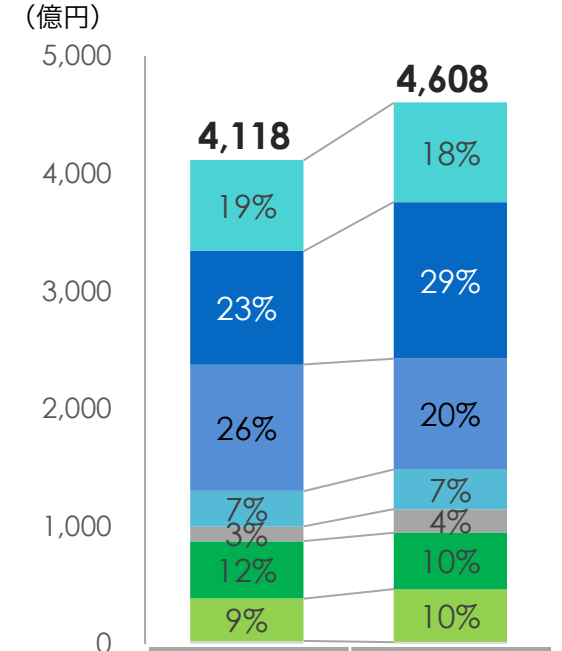
全社地域別売上高比率

四半期



地域	FY2022/03				FY2023/03			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
日本	174	196	191	211	157	248	203	238
台湾	112	306	264	281	245	338	440	304
中国	288	226	236	325	238	223	161	320
韓国	53	70	87	90	65	80	79	113
その他アジア	18	35	41	27	47	35	49	68
北米	95	141	117	135	151	115	104	108
欧州	80	59	95	127	107	118	125	98
その他	5	5	4	8	5	5	3	2

通期

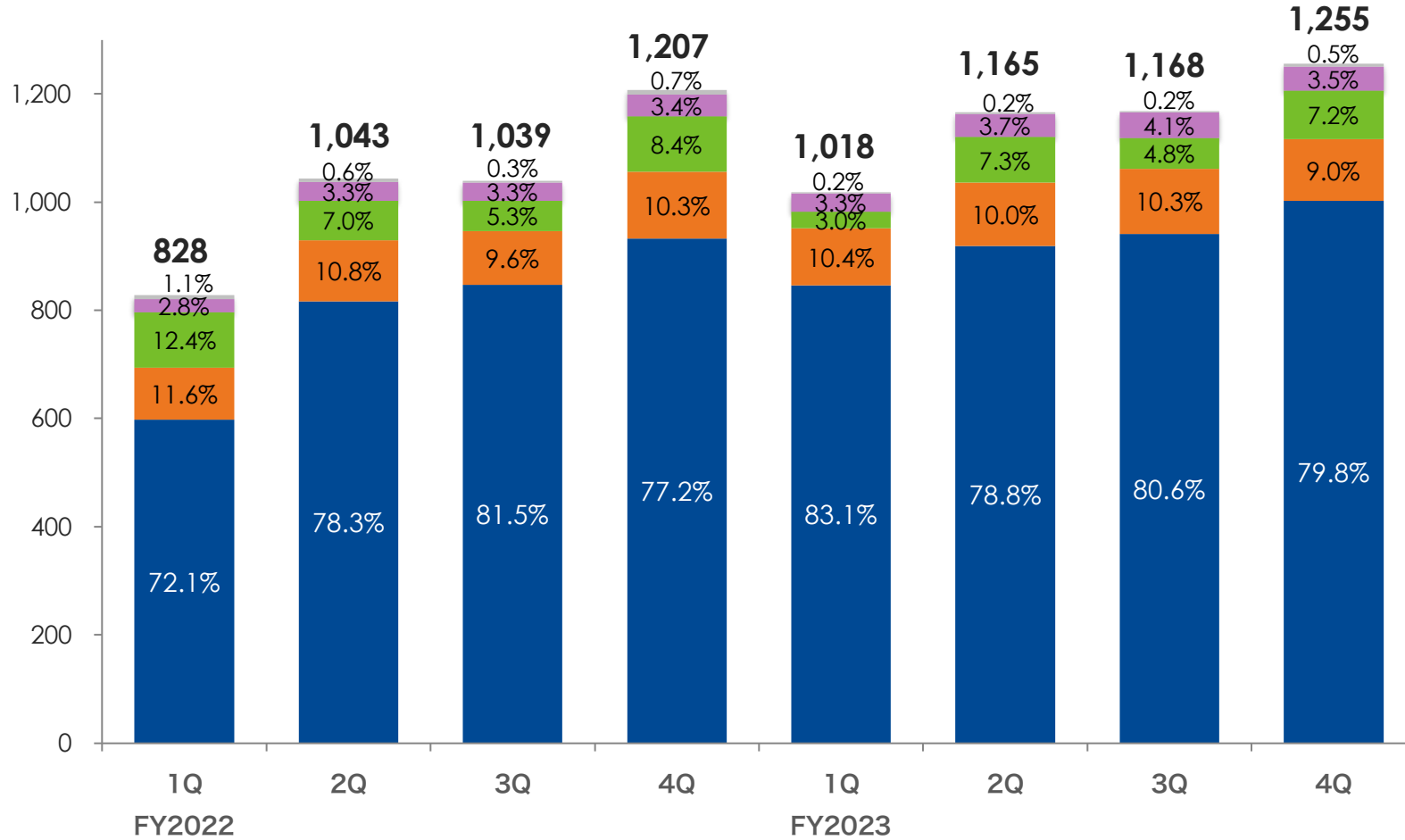


地域	FY2022/03	FY2023/03
日本	774	847
台湾	964	1,329
中国	1,077	943
韓国	302	339
その他アジア	123	200
北米	489	480
欧州	362	449
その他	23	16

セグメント別売上高比率

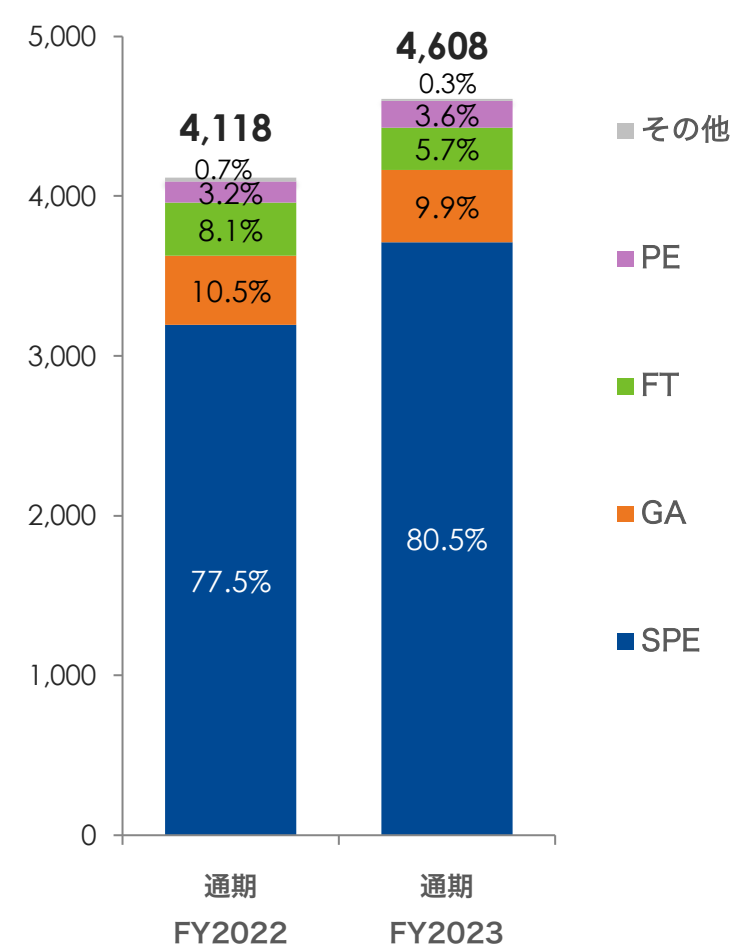
四半期

(億円)



通期

(億円)



FY2023/03 連結業績

セグメント別

	(億円)	FY2022/03				FY2023/03			
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
SPE	売上	597	816	846	932	846	919	941	1,002
	営業利益 営業利益率	88 14.9%	154 18.9%	171 20.2%	214 23.0%	188 22.3%	195 21.3%	173 18.5%	211 21.1%
GA	売上	96	112	99	123	105	116	120	113
	営業利益 営業利益率	2 2.7%	4 3.6%	4 4.3%	5 4.3%	6 6.4%	9 8.2%	10 9.0%	6 6.1%
FT	売上	102	72	55	101	30	84	56	90
	営業利益 営業利益率	2 2.2%	-0 -0.9%	-3 -5.5%	7 7.2%	-8 -27.0%	-2 -3.1%	-0 -0.8%	-7 -7.8%
PE	売上	23	34	33	40	33	42	47	44
	営業利益 営業利益率	2 9.0%	7 21.0%	6 17.8%	5 12.9%	4 14.0%	11 26.2%	10 21.1%	7 17.2%

	FY2022/03	FY2023/03
	通期	通期
売上	3,193	3,709
営業利益 営業利益率	628 19.7%	769 20.7%
売上	433	456
営業利益 営業利益率	16 3.8%	33 7.4%
売上	332	261
営業利益 営業利益率	5 1.8%	-18 -7.0%
売上	133	168
営業利益 営業利益率	20 15.6%	33 19.9%

FY2023/03 連結業績

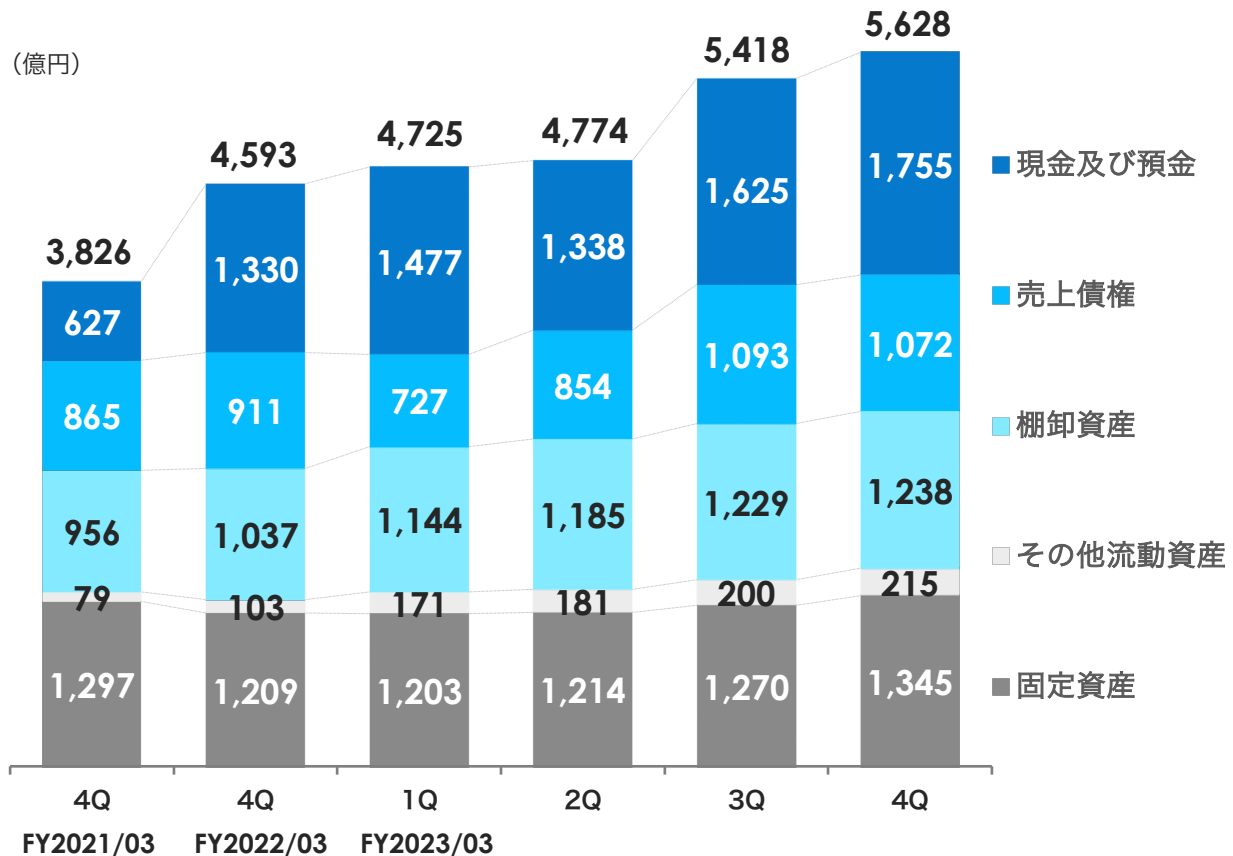
セグメント別

	(億円)	FY2023/03		QoQ			
		3Q	4Q	売上増減		営業利益増減	
SPE	売上	941	1,002	60	6.5%	38	22.0% 2.7pt
	営業利益 営業利益率	173 18.5%	211 21.1%	中国、韓国、日本向け売上が増加。原材料コスト高騰の中、利益率は21.1%に改善			
GA	売上	120	113	-6	-5.7%	-4	-36.8% -3.0pt
	営業利益 営業利益率	10 9.0%	6 6.1%	減収ながら想定範囲内。インクの売上は引き続き安定			
FT	売上	56	90	34	60.8%	-6	-% -7.0pt
	営業利益 営業利益率	-0 -0.8%	-7 -7.8%	増収ながら想定比減少（一部、来期へスライド）。コスト削減により赤字幅は改善			
PE	売上	47	44	-3	-6.9%	-2	-23.8% -3.8pt
	営業利益 営業利益率	10 21.1%	7 17.2%	減収するも、利益ともに想定比上振れ			

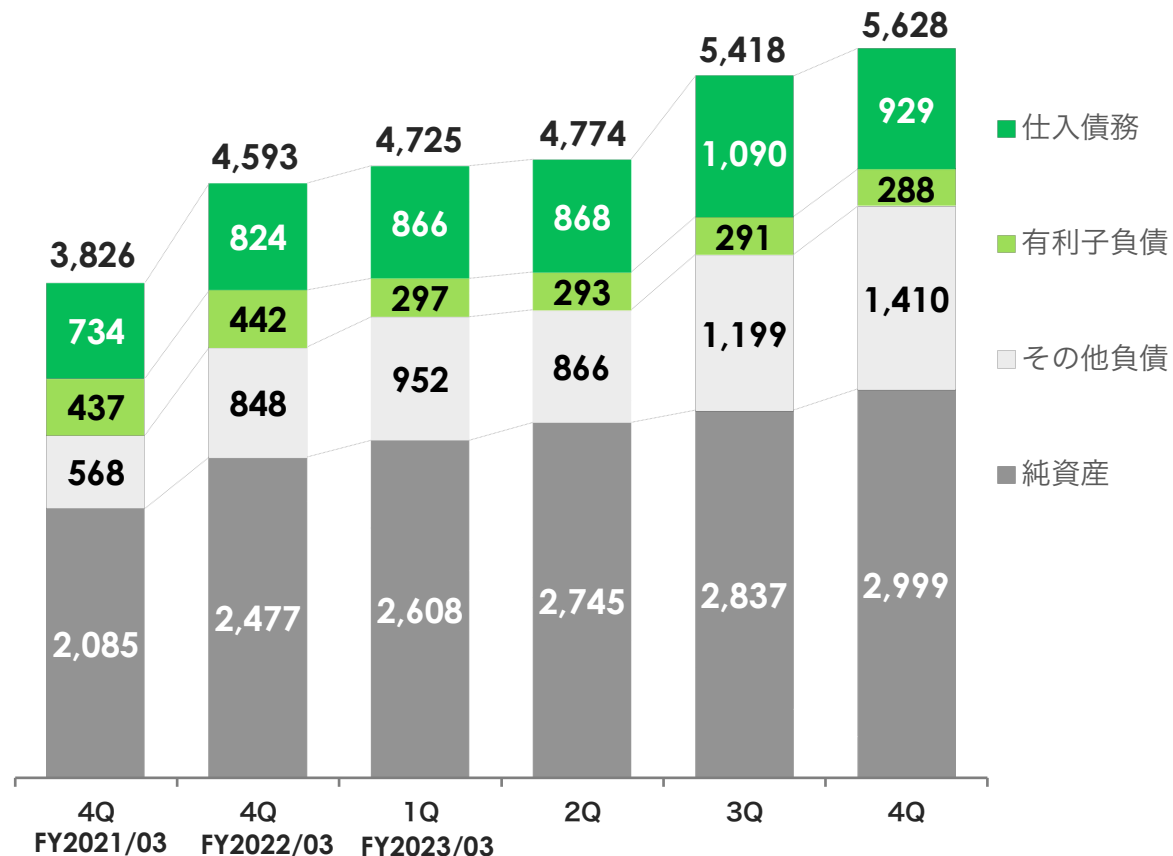
	FY2022	FY2023	YoY			
	通期	通期	売上増減		営業利益増減	
	3,193	3,709	515	16.1%	141	22.5% 1.0pt
	628 19.7%	769 20.7%	メモリー向けは減少したものの、ファウンドリー、ロジック向けが牽引し、増収増益 台湾、欧州向け売上が増加			
	433	456	22	5.3%	17	107.6% 3.6pt
	16 3.8%	33 7.4%	POD中心に装置、リカーリングビジネスともに堅調に推移、増収増益			
	332	261	-70	-21.3%	-24	-% -8.8pt
	5 1.8%	-18 -7.0%	顧客の設備投資低迷を受け、売上、利益ともに減少			
	133	168	35	26.5%	12	61.9% 4.3pt
	20 15.6%	33 19.9%	データセンター需要の拡大を受け、直接描画装置販売が好調。増収増益			

財務状況：連結貸借対照表

資産



負債および純資産



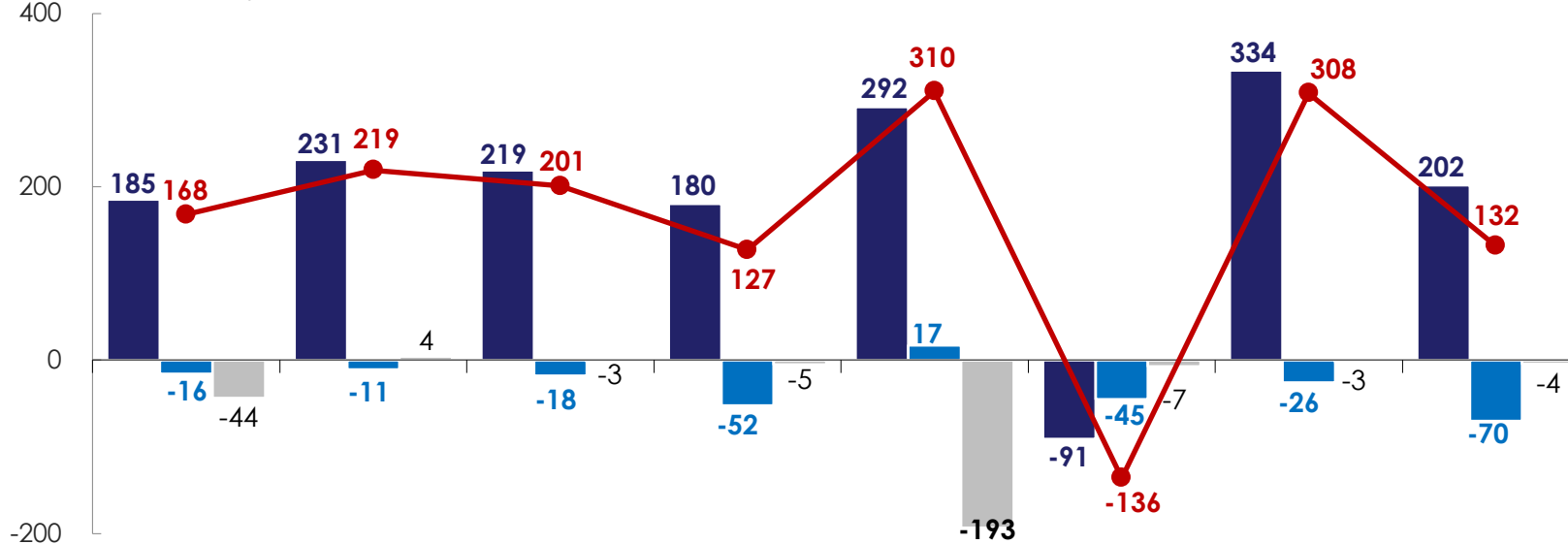
■ 自己資本比率は**53.3%** (FY2023/03 4Q)

■ **1,467億円**のネットキャッシュ

財務状況：連結キャッシュ・フロー

四半期

(億円) 営業CF 投資CF 財務CF FCF

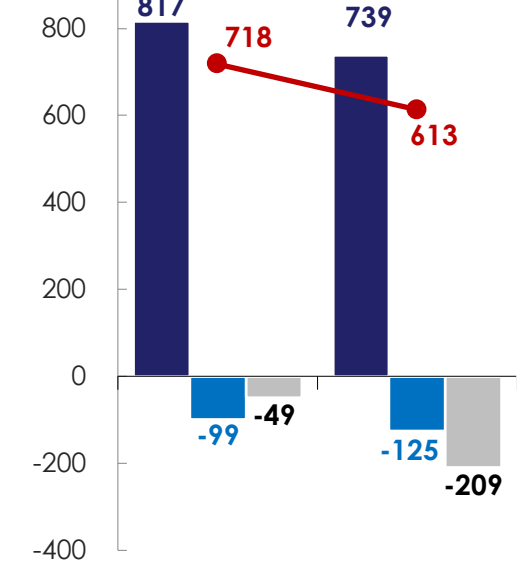


(億円)

	FY2022/03				FY2023/03			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
営業CF	185	231	219	180	292	-91	334	202
投資CF	-16	-11	-18	-52	17	-45	-26	-70
FCF	168	219	201	127	310	-136	308	132
財務CF	-44	4	-3	-5	-193	-7	-3	-4

通期

(億円)



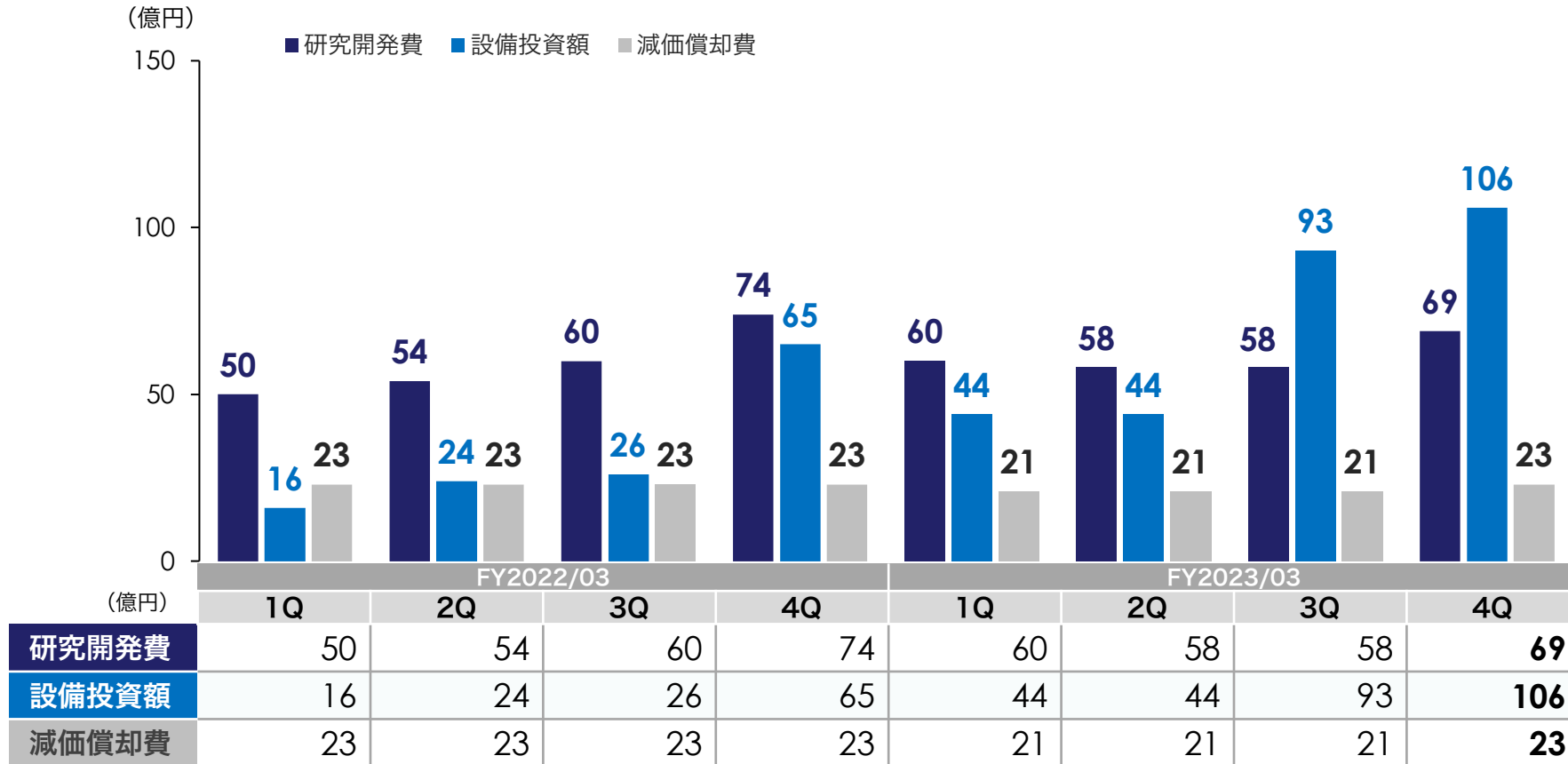
	FY2022/03	FY2023/03
営業CF	817	739
投資CF	-99	-125
FCF	718	613
財務CF	-49	-209

※ FCF：フリーキャッシュ・フロー

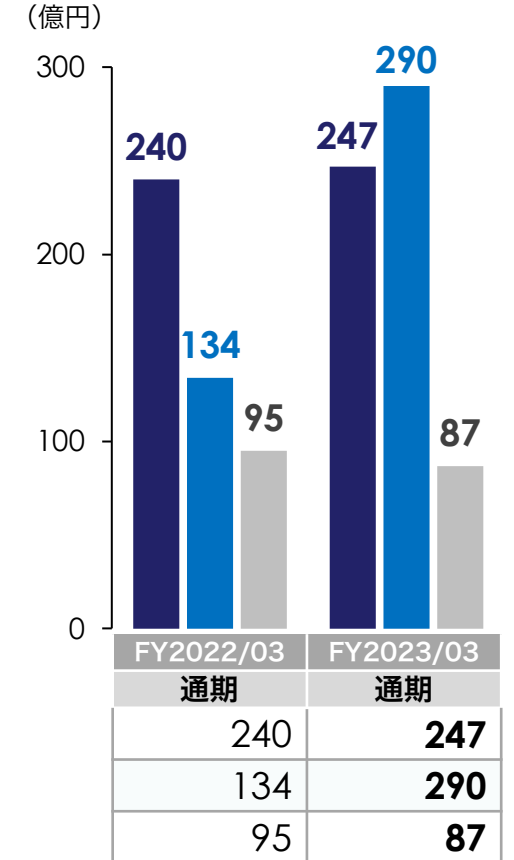
■ 通期の営業CFは、堅調に推移

研究開発費・設備投資額・減価償却費

四半期



通期

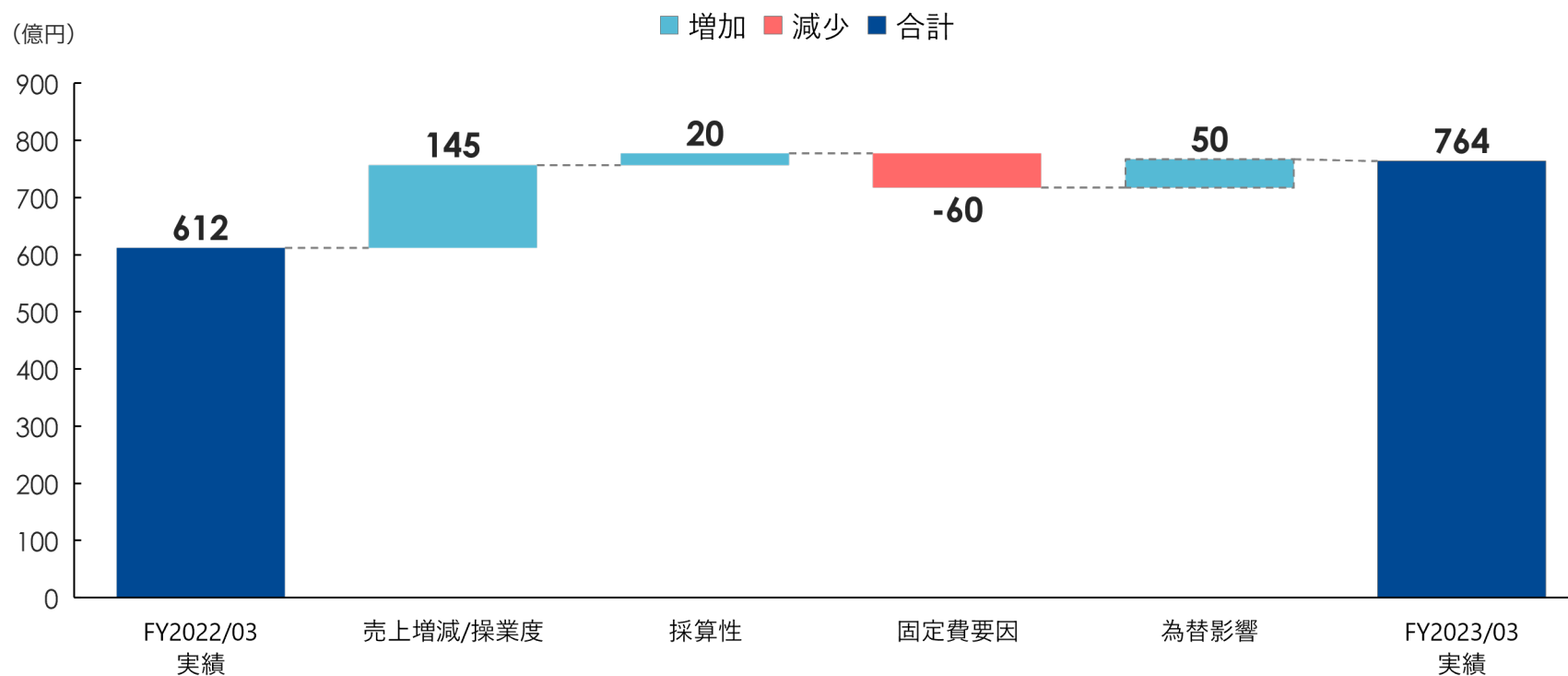


■研究開発費：SPE中心に、新規事業領域（ライフサイエンス、AI、アドバンスドパッケージ、エネルギー/水素関連分野）への新製品開発など

■設備投資額：SPEの新工場S³-4竣工、S³-5着工など、生産・サービス体制強化

営業利益増減分析

FY2022/03 実績 vs FY2023/03 実績



※利益要因は、5億円刻みの「約」表記

>>売上増減/操業度、採算性改善のほとんどがSPE

>>固定費の増加要因は、主にSPEの成長投資（人件費、業績連動賞与、研究開発費など）

>>為替は、SPE、GA、PEに影響

事業環境および業績予想

2023年5月10日

株式会社SCREENホールディングス
代表取締役 取締役社長 最高経営責任者（CEO）

廣江 敏朗

事業環境および業績予想

■ 事業環境

- SPE：メモリーメーカーの設備投資に縮小の動きが見られたものの、DXの進展やGXを背景にした微細化や、パワー半導体をはじめとする成熟世代半導体への投資は底堅く推移するものと予想
→生産体制の拡張を進め、製品シェア拡大を目指す
- GA：米国でPODが堅調、今期も安定推移を目指す
- FT、PE：市場回復を待ちながら、次期成長に向け開発投資を強化

■ 通期業績予想

- FY2024・通期予想は、前期比、増収増益
→売上、営業利益（率）ともに、3年連続で過去最高を更新予定
- FY2024・配当、前期比増配を予想（中間配当を導入）
- 中期経営計画最終年度、持続的な成長に向けた投資継続

市場動向および見通し

- **WFE：2023年は前年比、20%程度の減少を見込む**
 - ・ファウンドリー・ロジック：投資する技術ノードを柔軟に調整しつつ、最先端への投資も継続
 - ・メモリー：投資減速からの回復タイミングを注視
- **アプリケーション別の動向**

ファウンドリー	世界各地域でのプロジェクトが着実に進行
ロジック	投資規模の調整はあるも、先端中心に投資継続
メモリー	投資抑制、減産からの回復時期を注視
画像素子	日本およびアジアでの投資が堅調に推移
パワーデバイス	欧州大手中心に、日本・アジア・北米での投資も堅調に推移
その他	アナログ、センサー、光学、素材など堅調な投資が継続

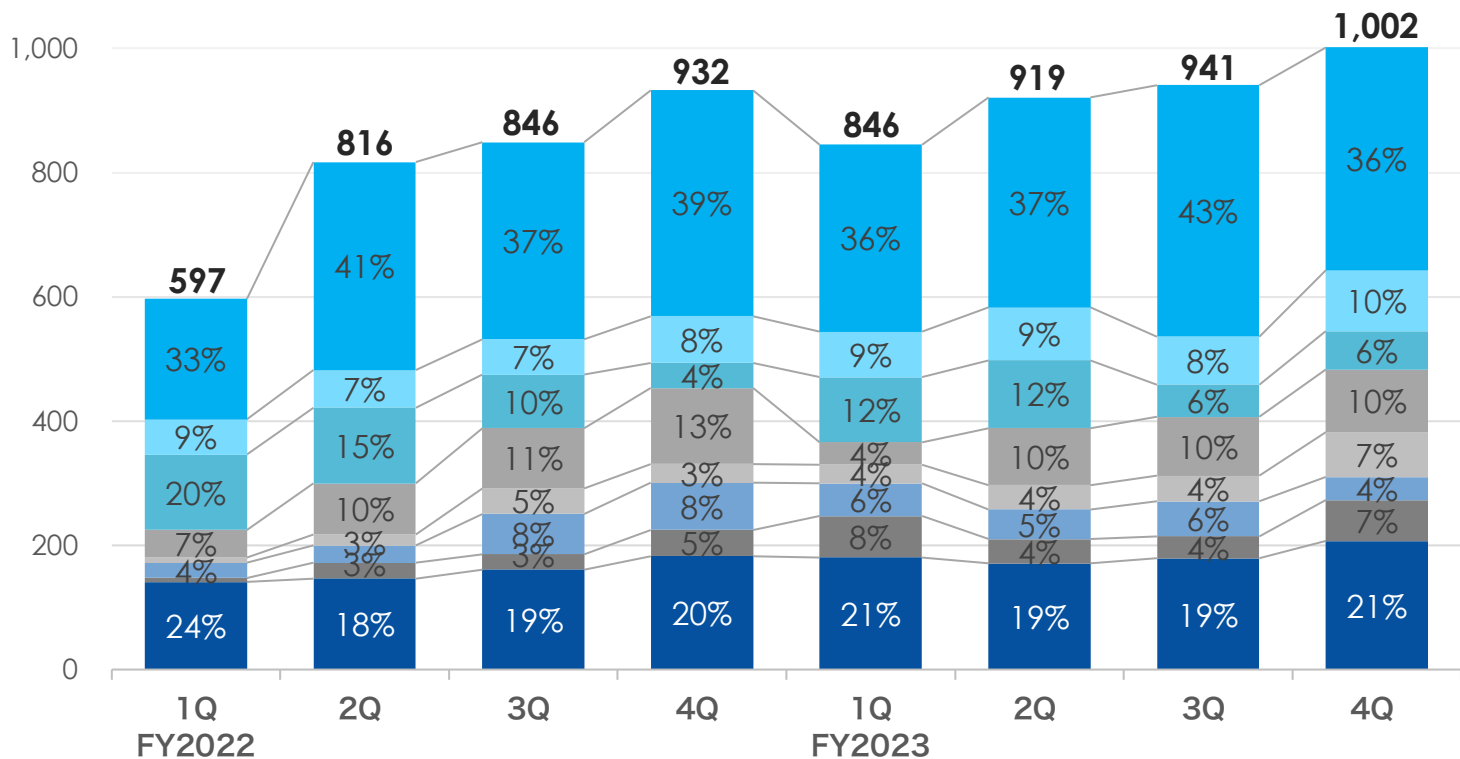
- **中国市場：レガシーノードへの活発な投資が継続**

▲ **微細化に伴う洗浄ニーズが高まる最先端ノードから成熟ノードまで、多様なソリューションを提供
>>生産・開発体制の強化を着実に推し進め、成長を続ける半導体市場の発展に貢献**

SPE 連結・新規装置アプリケーション別、およびポストセールス売上推移

四半期

(億円)

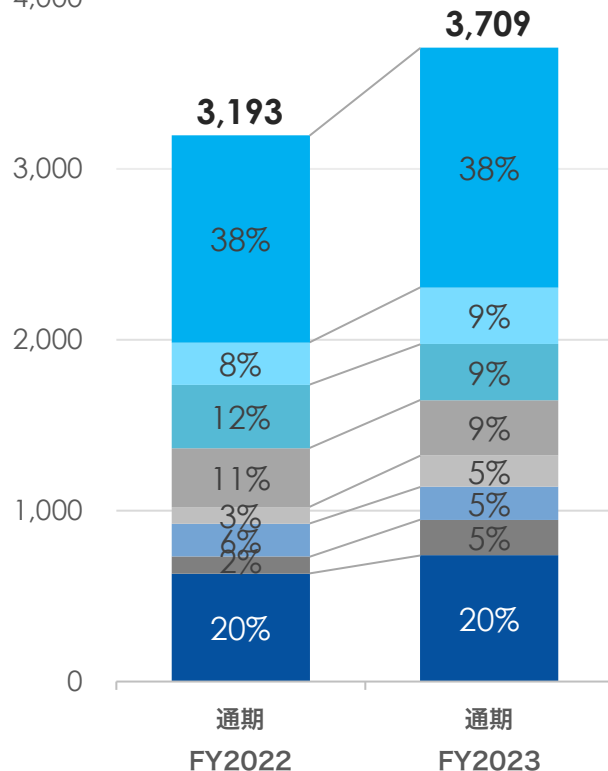


ポストセールス
売上高 (億円)

141 147 161 183 181 171 179 **207**

通期

(億円)
4,000



631 **738**

- ファウンドリー
- ロジック
- Flash
- DRAM
- 画像素子
- パワーデバイス
- その他
- ポストセールス

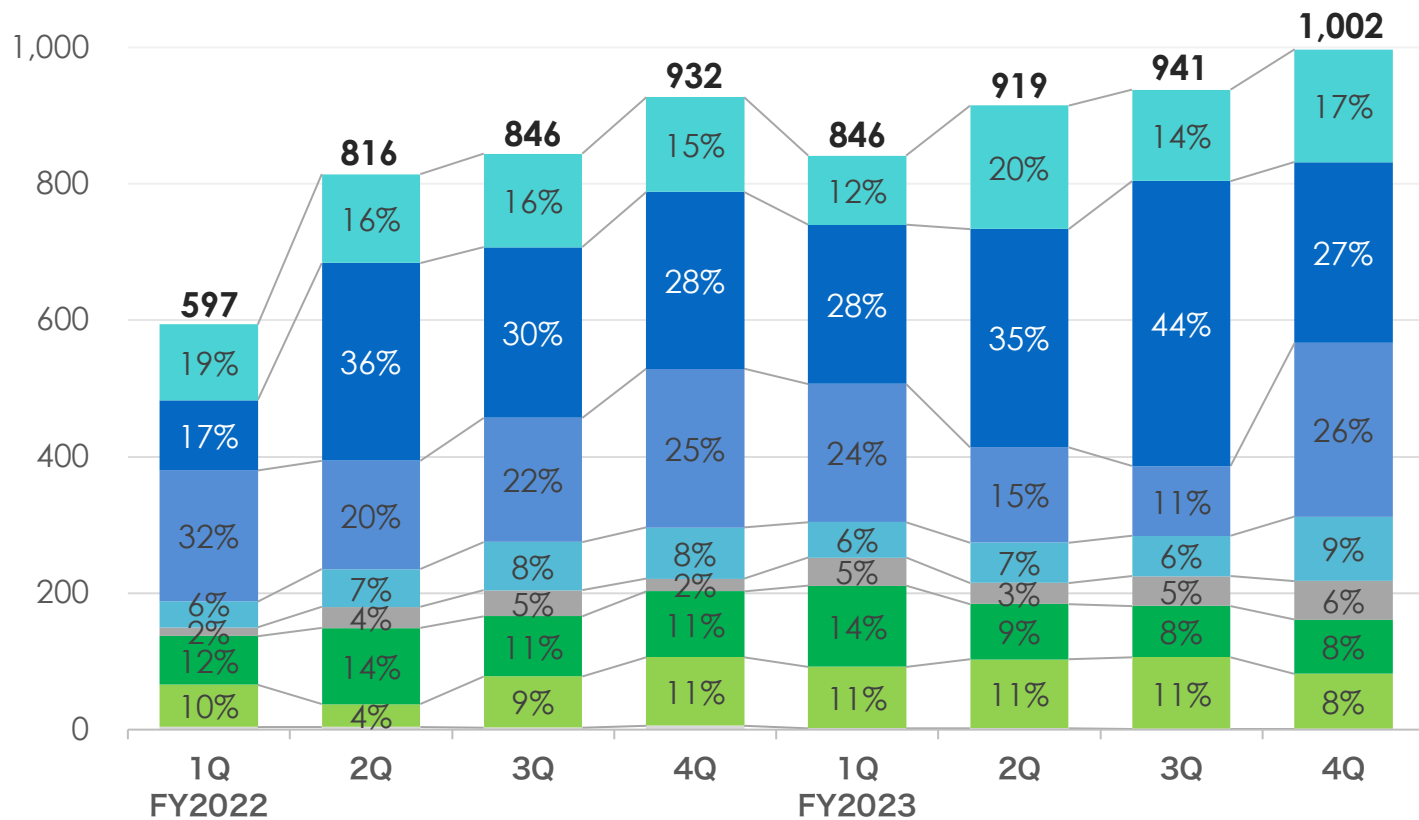
注) ポストセールス売上高は、過去の発表数字に集計上の訂正を入れてます

- アプリケーション別：(QoQ) ロジック、画像素子で増。通期(YoY) ファウンドリー・ロジック堅調
- ポストセールス：(QoQ) 3Qからのシフト案件が4Qで売上。通期(YoY) 比率は20%。売上は着実に増加

SPE 連結地域別売上高比率 - 仕向地ベース

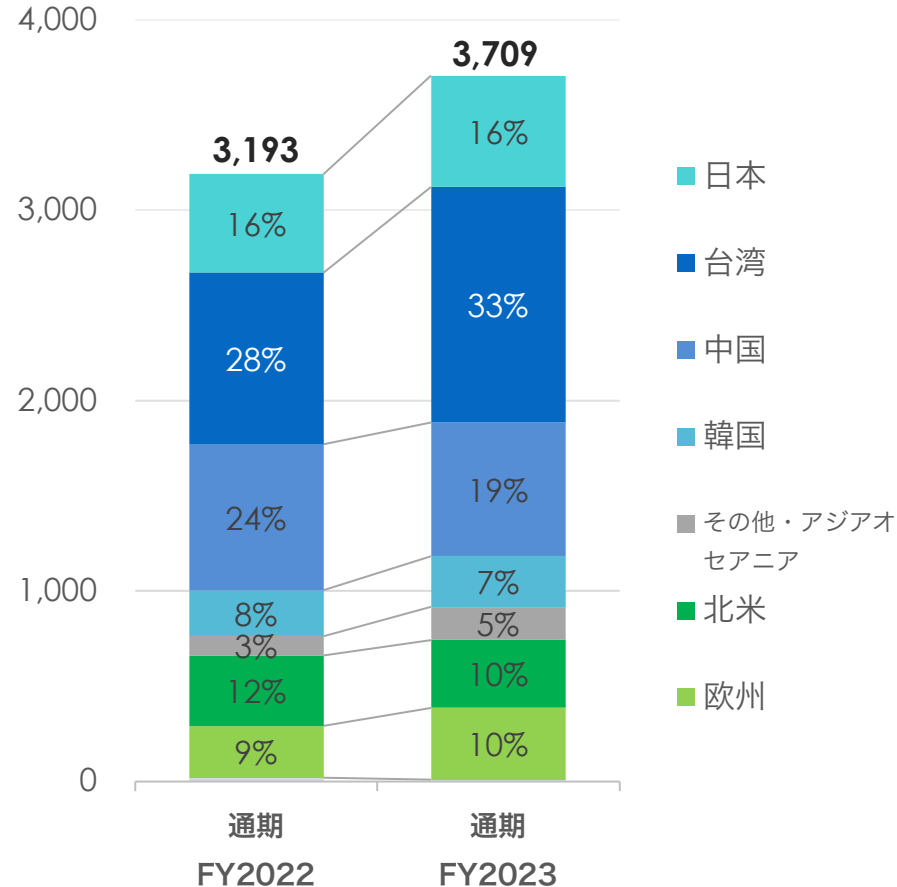
四半期

(億円)



通期

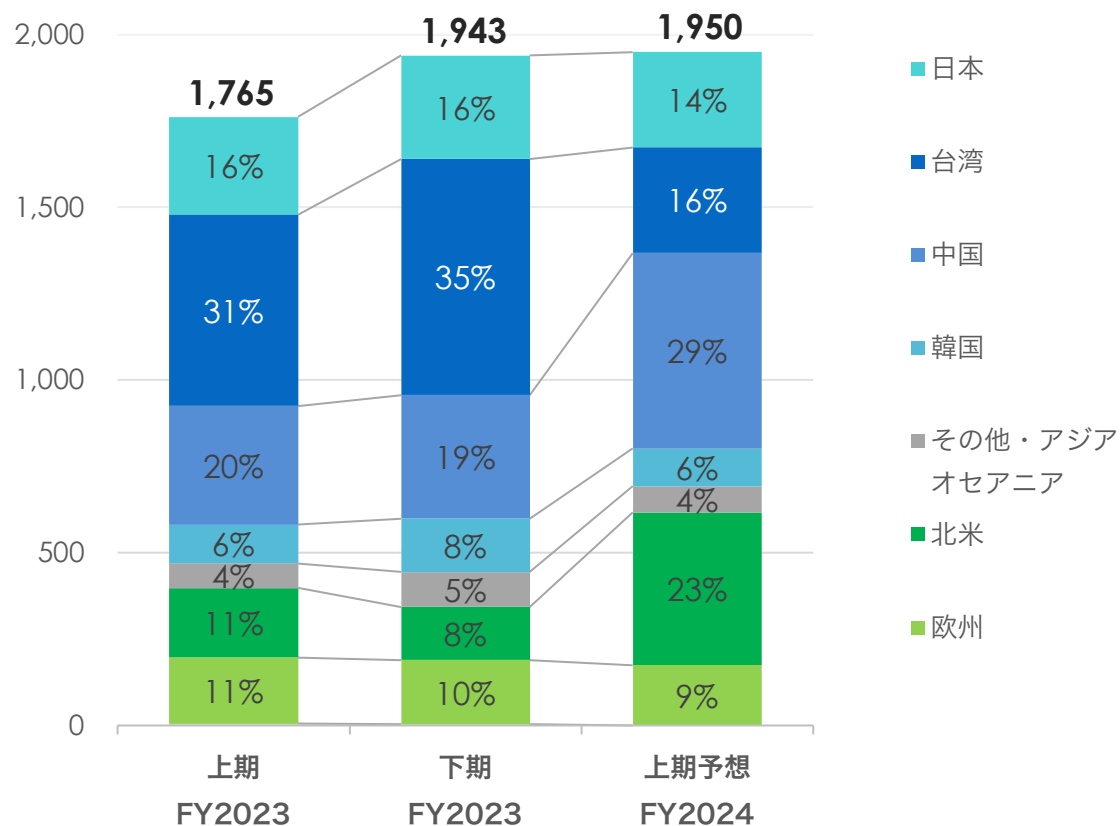
(億円)



- (QoQ) : 中国が大幅増。日本、韓国も増加
- (YoY) : 台湾比率増加、欧州が微増

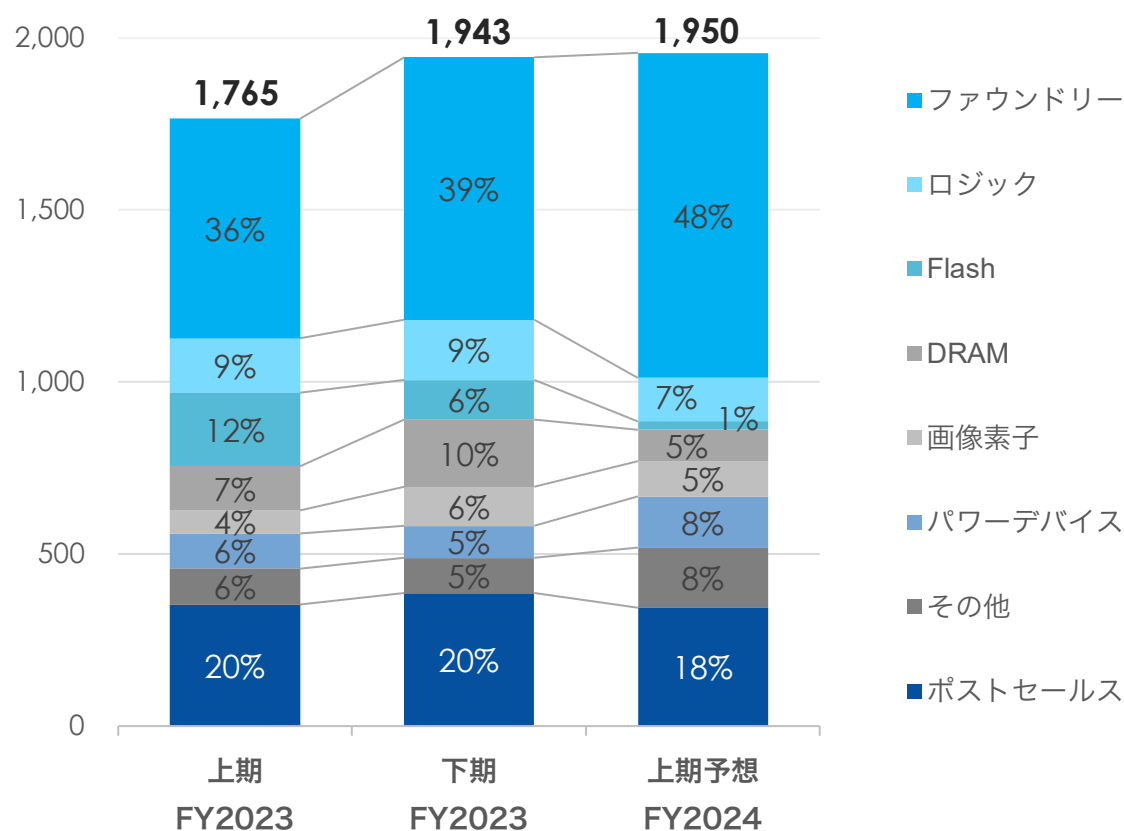
地域別 - 仕向地ベース

(億円)



アプリケーション (デバイス) 別

(億円)



■ 地域別：上期予想 中国、北米で大幅に増加見込み

■ アプリケーション別：上期予想 ファウンドリーが大幅増。パワーデバイスも増加見込み

Topics>>

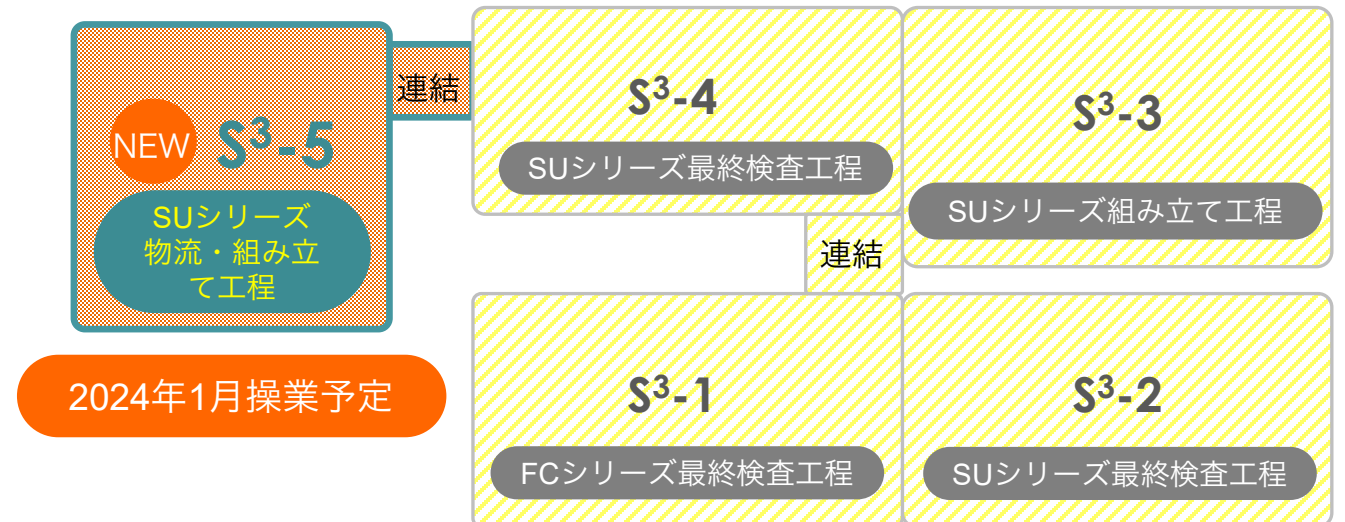
彦根事業所 さらなる生産増強に向け半導体製造装置工場 S³-5 建設中S³-5建築面積：5,057m²延床面積：12,325m²

■ SUシリーズ(枚葉洗浄装置)生産の物流機能と組立機能を強化

- S³-3から仕分け機能を一部移転し、S³-3の組立能力を増強 (S³-4の完成から、さらに生産能力 20% アップ)
- S³-4と連結して建設。S³-1~5各工場がクリーントンネルでつながり、部品受け入れ~生産から出荷まで、従来に増して効率的な生産フローを実現。

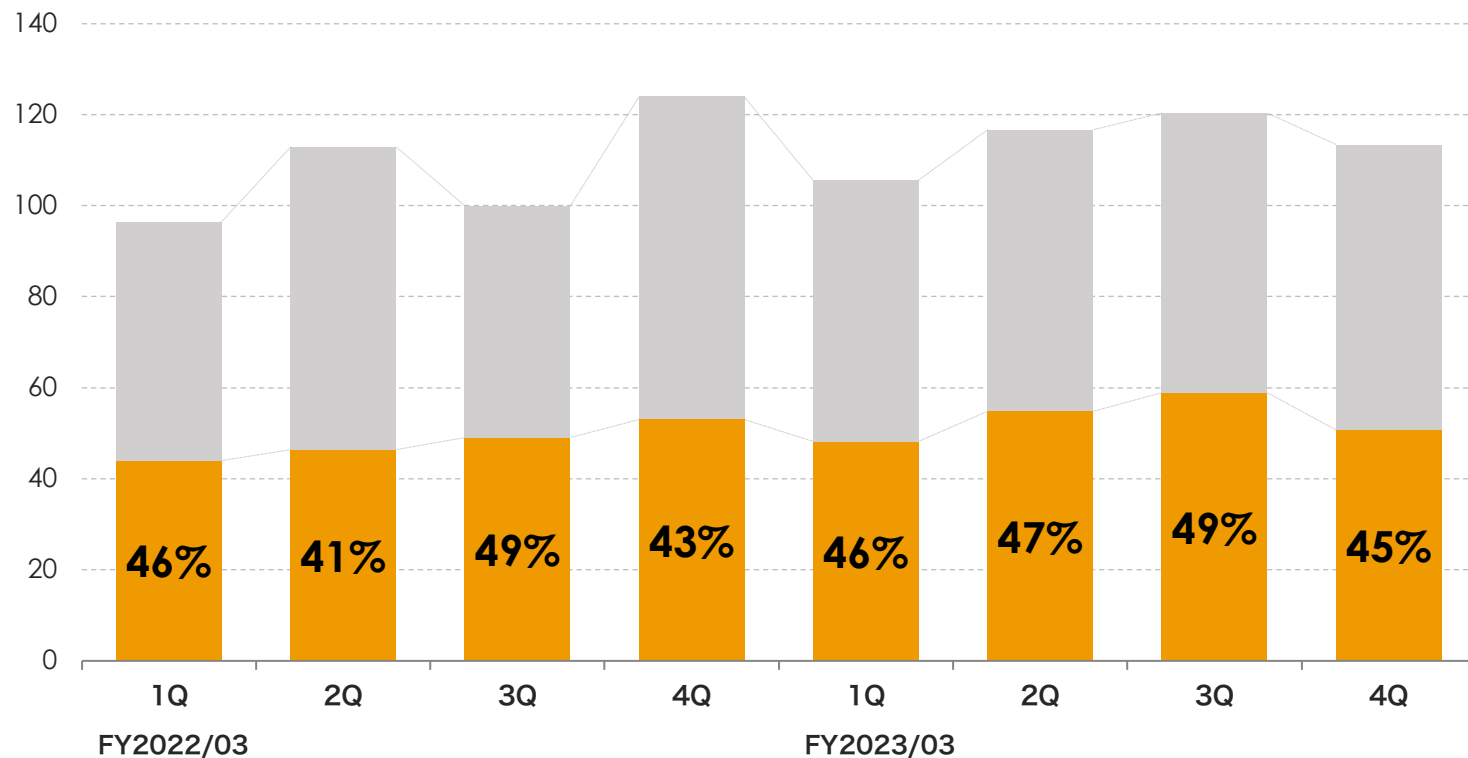
→ 2024年1月、操業開始予定

■ 各工場連結イメージ図



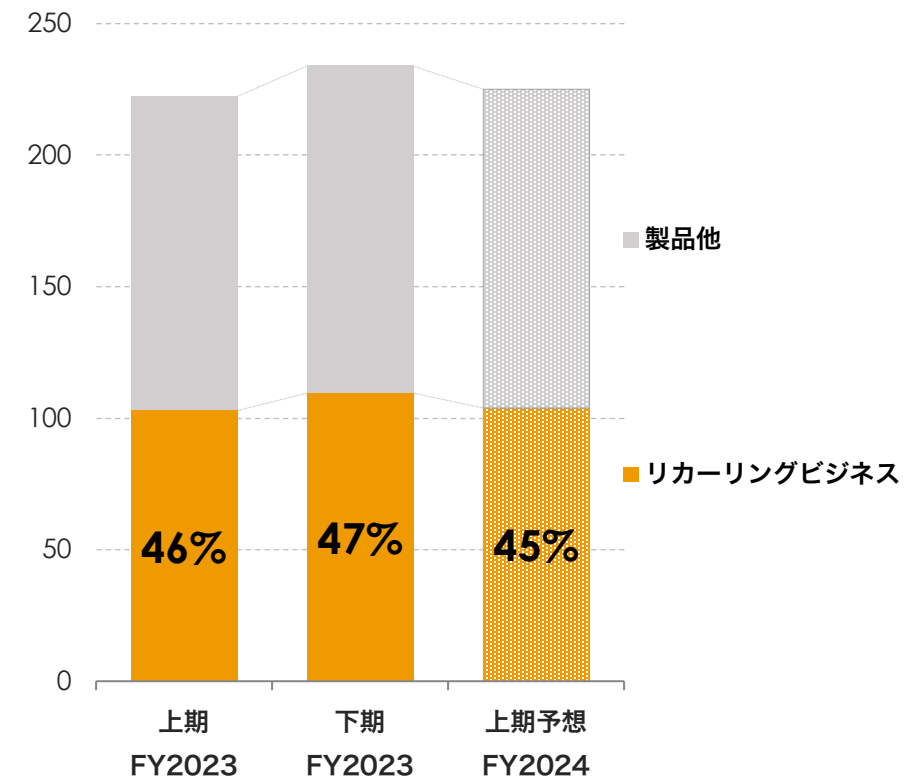
四半期

(億円)



予想

(億円)



*注) 予想比率は、5%刻みの「約」表記

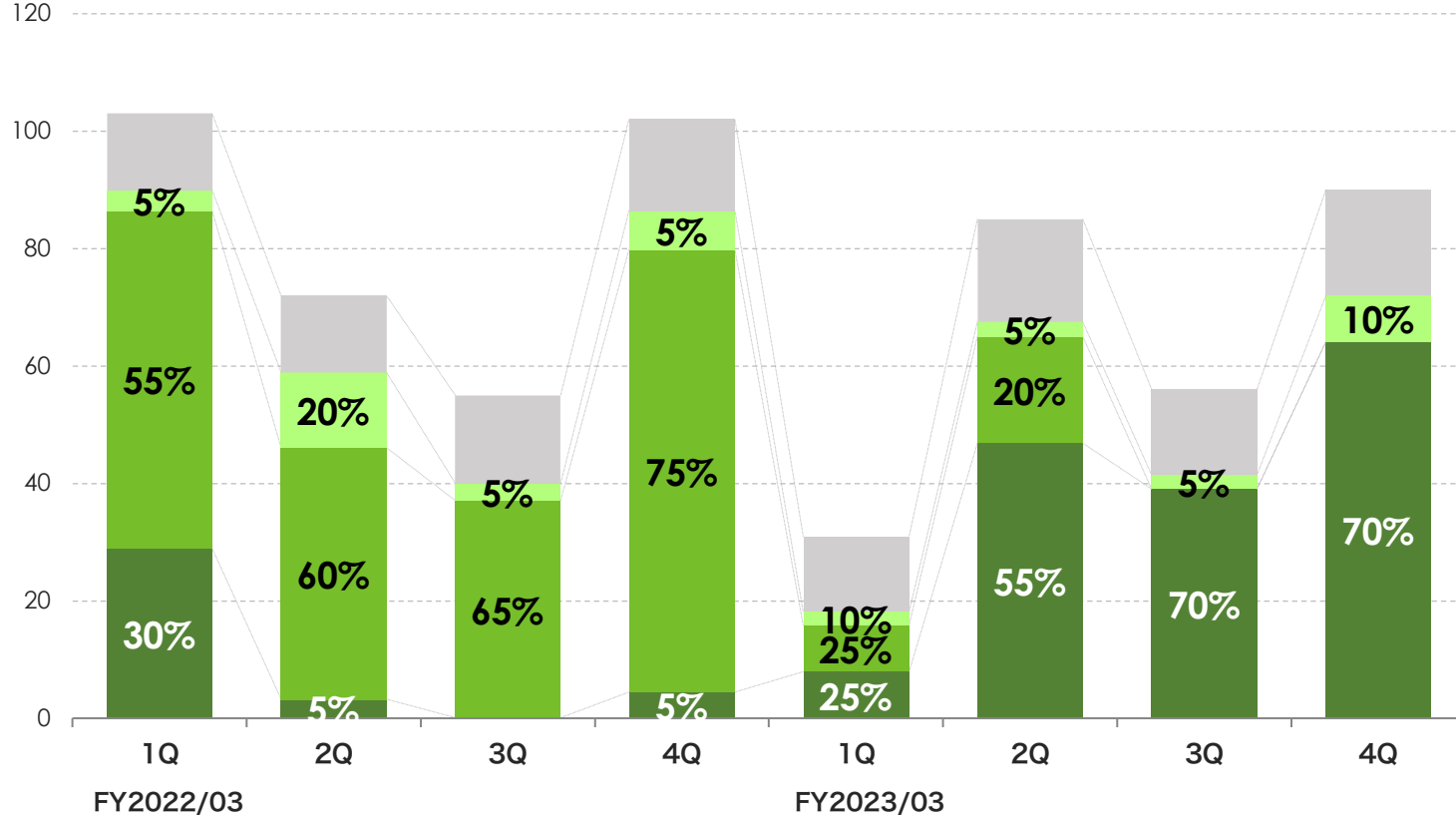
- インクを中心とするリカーリングビジネス (RB) は引き続き堅調
- 北米中心に旺盛なPOD需要は続くと予想
- 為替影響の追い風も受けて、通期、営業利益率は7%台を維持継続

FT 連結売上高推移

FT

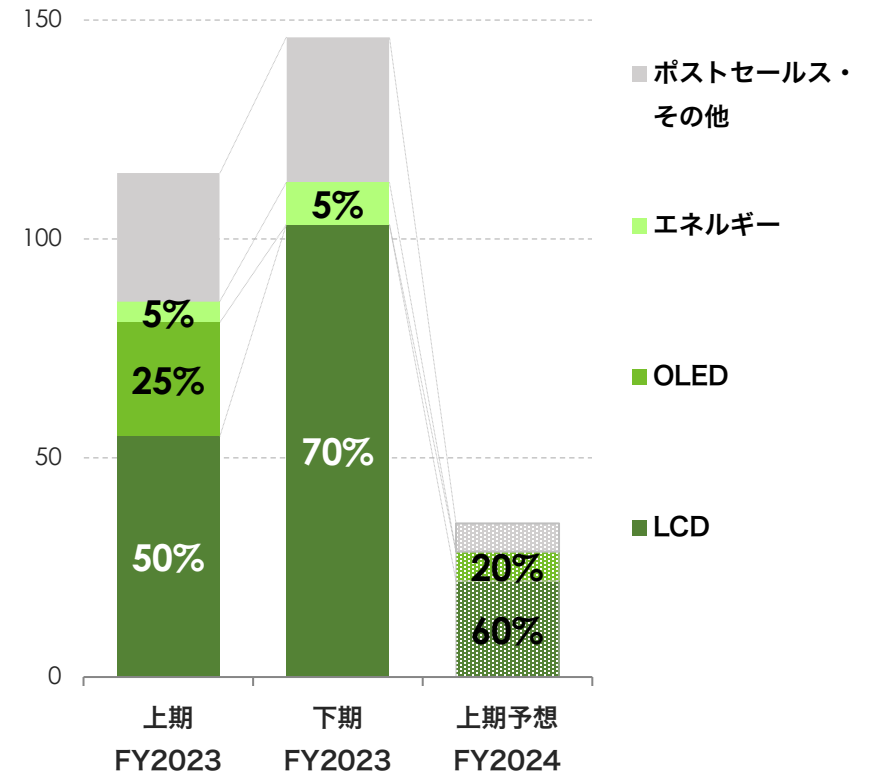
四半期

(億円)



予想

(億円)

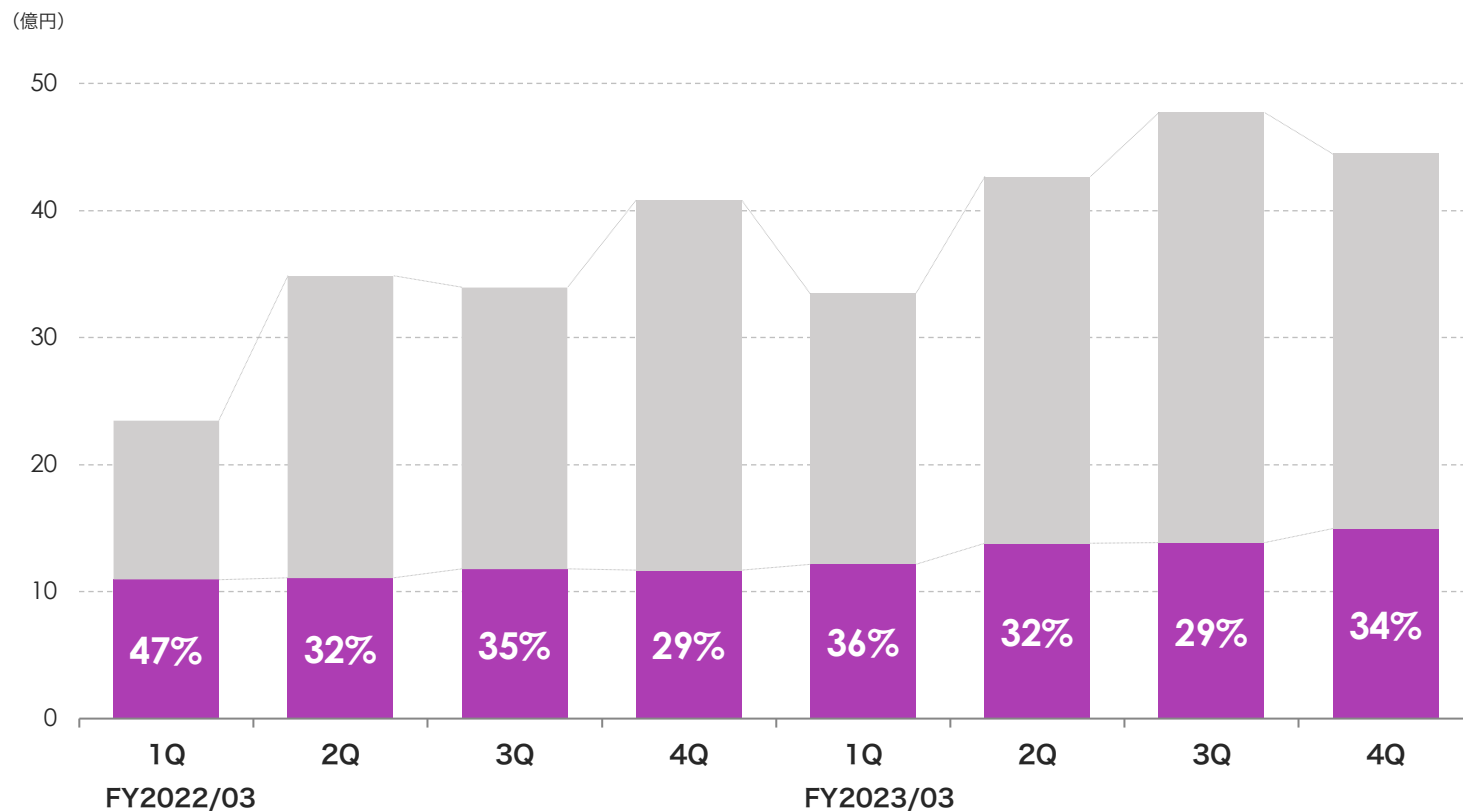


*注) 予想比率は、5%刻みの「約」表記。FY2024から、エネルギーはその他に含める

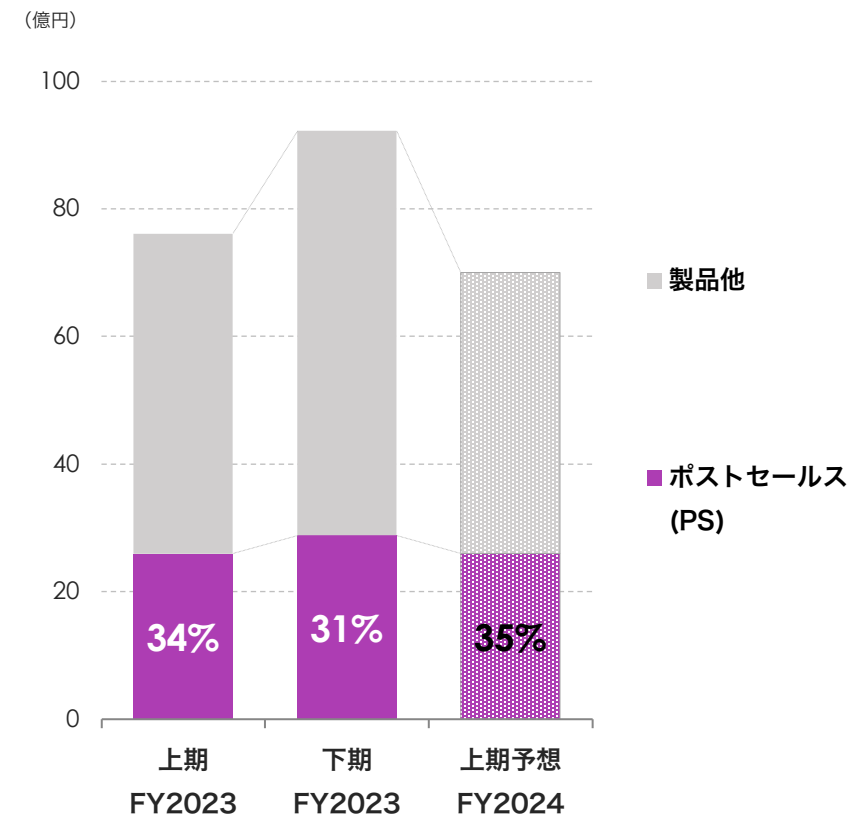
- ディスプレー市場はCY2023も不透明な環境が続くと予想。来期のG8 OLED向け投資をターゲットに、新製品の販促活動を展開
- HDにエネルギー（水素関連領域）を移管、ディスプレイ事業に集中

PE 連結売上高推移

四半期



予想



*注) 予想比率は、5%刻みの「約」表記

- 半導体市況動向を受け、データセンター向け需要は一服感あり
- 市場回復後の成長に向け、新製品投入を目指す
- 安定した営業利益の創出を見込む

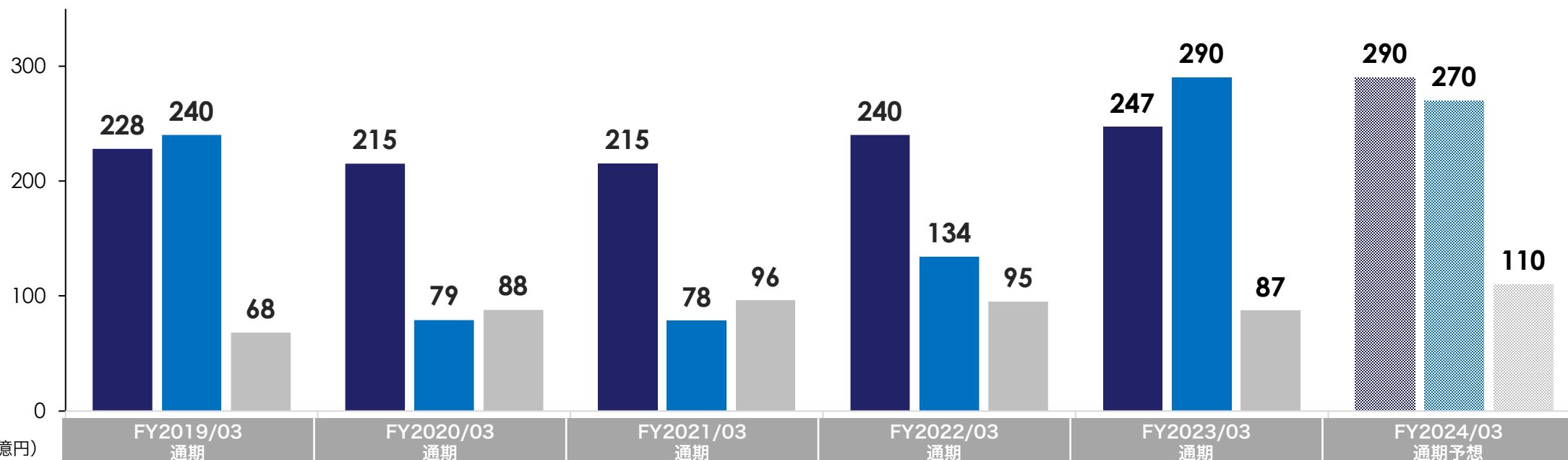
FY2024/03 業績予想 (2023年5月10日時点)

(億円)		FY2023/03 実績			FY2024/03 予想		
		上期	下期	通期	上期	下期	通期
売上高		2,184	2,424	4,608	2,290	2,660	4,950
営業利益		381	382	764	355	495	850
営業利益率		17.5%	15.8%	16.6%	15.5%	18.6%	17.2%
経常利益		386	387	773	340	480	820
親会社株主に帰属する 当期純利益		296	277	574	220	360	580
SPE	売上	1,765	1,943	3,709	1,950	2,150	4,100
	営業利益 営業利益率	383 21.7%	385 19.8%	769 20.7%	395 20.3%	505 23.5%	900 22.0%
GA	売上	222	233	456	225	235	460
	営業利益 営業利益率	16 7.3%	17 7.6%	33 7.4%	15 6.7%	20 8.5%	35 7.6%
FT	売上	115	146	261	35	185	220
	営業利益 営業利益率	-10 -9.4%	-7 -5.1%	-18 -7.0%	-20 -57.1%	5 2.7%	-15 -6.8%
PE	売上	76	92	168	70	75	145
	営業利益 営業利益率	15 20.8%	17 19.2%	33 19.9%	10 14.3%	10 13.3%	20 13.8%
その他および調整	売上	4	7	12	10	15	25
	営業利益	-23	-30	-54	-45	-45	-90

注) FY2024/03 (通期) 想定為替レート>> 1USD=¥125、1EUR=¥135
 想定為替感応度 (通期営業利益ベース) >> 対USD: ¥2.0億、対EUR: ¥0.3億

FY2024/03 研究開発費・設備投資計画

(億円) ■ 研究開発費 ■ 設備投資額 ■ 減価償却費



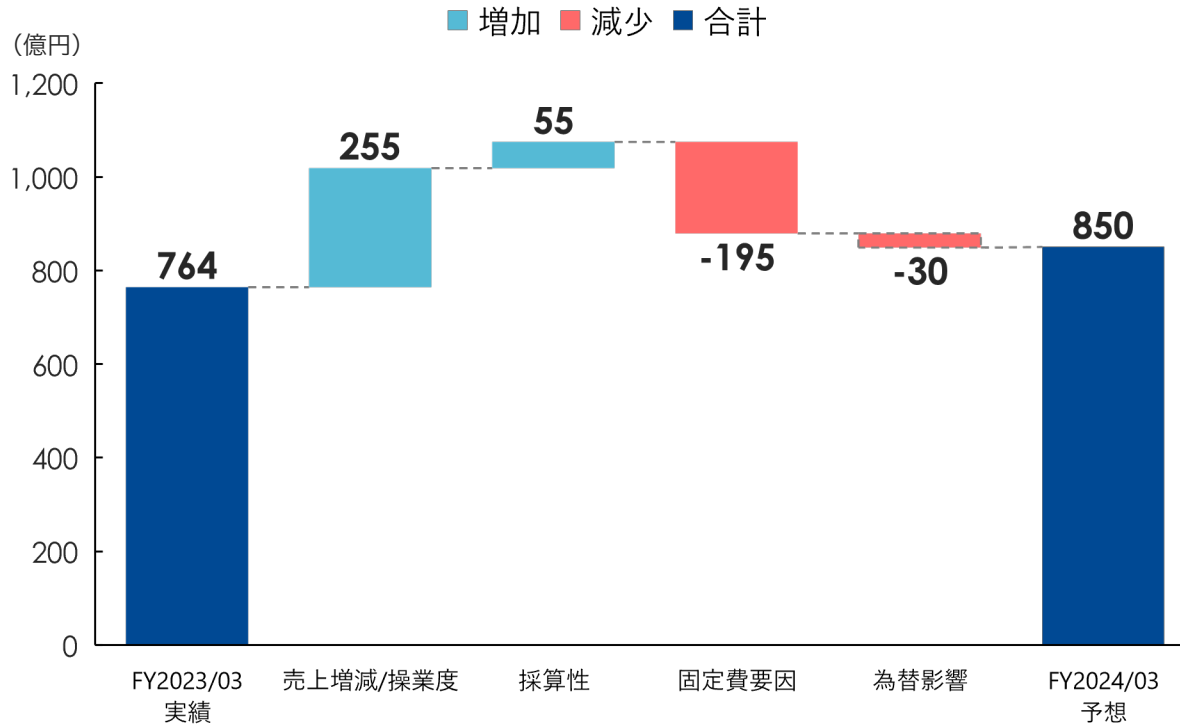
(億円)	FY2019/03 通期	FY2020/03 通期	FY2021/03 通期	FY2022/03 通期	FY2023/03 通期	FY2024/03 通期予想
研究開発費	228	215	215	240	247	290
設備投資額	240	79	78	134	290	270
減価償却費	68	88	96	95	87	110

■ 研究開発費：SPE中心に戦略投資、新規事業領域（LS、AI、ADPKGにエネルギー/水素関連を追加）での成長を強化

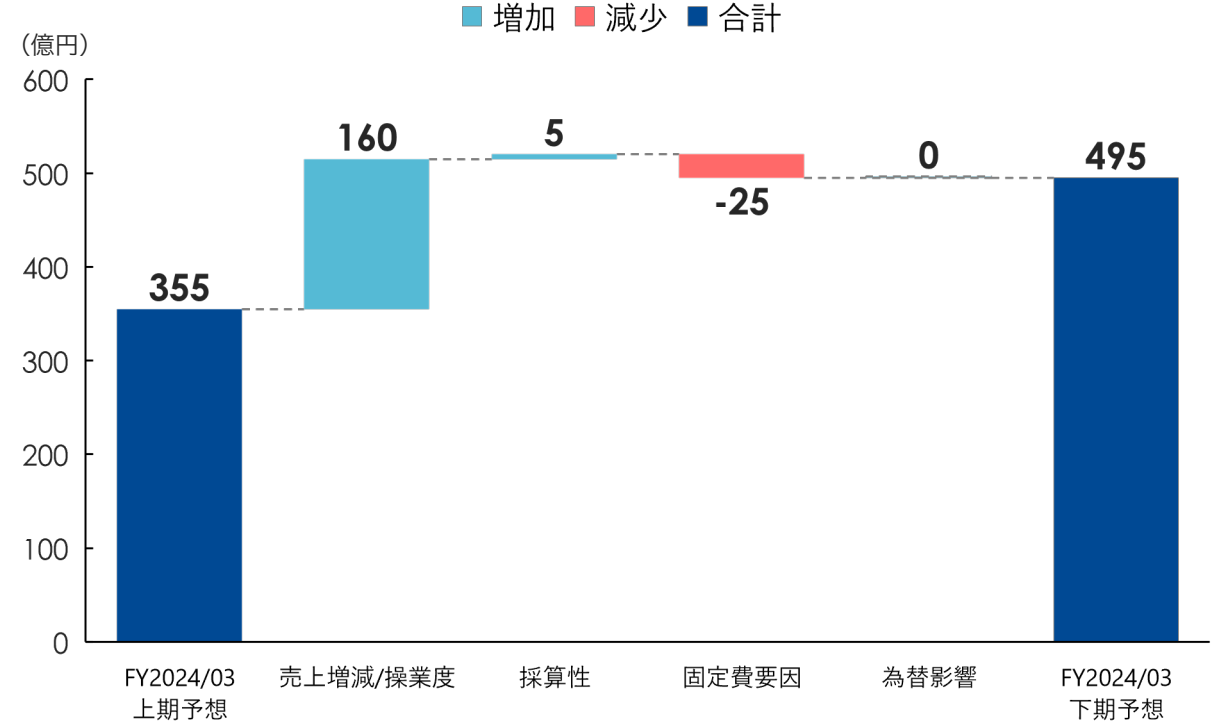
■ 設備投資額：SPEの新工場S³-5に加え、グループ会社の生産・サービス体制も強化

営業利益増減分析

FY2023/03 実績 vs FY2024/03 予想



FY2024/03 上期予想 vs 下期予想



※利益要因は、5億円刻みの「約」表記

- >>売上増減/操業度のほとんどがSPE
- >>採算性のほとんどがSPE
- >>固定費の増加要因は、主にSPEの成長投資（人件費、業績連動賞与、研究開発費など）
- >>為替は、SPE、GA、PEに影響

- >>売上増減/操業度はほとんどがSPE、続いてFT
- >>採算性のほとんどがSPE
- >>固定費の増加要因は、主にSPEの成長投資（人件費、業績連動賞与、研究開発費など）

株式分割のお知らせ

目的	投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図る										
分割の方法	<p>2023年9月30日（土）を基準日として、同日付の株主が所有する当社普通株式を、1株につき2株の割合をもって分割</p> <table data-bbox="733 668 1811 968"><tr><td>株式分割前の発行済株式総数</td><td>50,794,866株</td></tr><tr><td>株式分割後の発行済株式総数</td><td>101,589,732株</td></tr><tr><td colspan="2">(定款変更)</td></tr><tr><td>株式分割前の発行可能株式総数</td><td>180,000,000株</td></tr><tr><td>株式分割後の発行可能株式総数</td><td>360,000,000株</td></tr></table>	株式分割前の発行済株式総数	50,794,866株	株式分割後の発行済株式総数	101,589,732株	(定款変更)		株式分割前の発行可能株式総数	180,000,000株	株式分割後の発行可能株式総数	360,000,000株
株式分割前の発行済株式総数	50,794,866株										
株式分割後の発行済株式総数	101,589,732株										
(定款変更)											
株式分割前の発行可能株式総数	180,000,000株										
株式分割後の発行可能株式総数	360,000,000株										
日程	基準日公告日: 2023年9月15日（金） 基準日 : 2023年9月30日（土） 効力発生日 : 2023年10月1日（日）										

配当について

2023年3月期

● 過去最高を更新

- ・ 中期経営計画「Value Up 2023」の連結総還元性向30%以上方針に沿って、株主様へ還元

2024年3月期

● 過去最高を更新予定

● 中間配当制度を導入

>>株主様への利益還元機会を充実

- ・ 中間配当基準日 毎年9月30日
- ・ 第82回定時株主総会に付議予定 (2023年6月23日開催予定)

2023年3月期		
1株当たり 期末配当	365円	・ 親会社株主に帰属する当期純利益が1月予想からの上振れを踏まえ増配(2023年6月株主総会で決議予定) ・ 分割前株式数を基準に配当

2024年3月期 (予想)			
		備考	株式分割 前換算
1株当たり 中間配当	140円	分割前株式数を基準に配当	140円
1株当たり 期末配当	114円	分割後株式数を基準に配当 (1株につき2株の割合で分割)	228円
合計	—	単純合計できないため非表示	368円

	経済的価値 最終年度の目標 (計画立案当初)	FY2021/03 (1年目 実績)	FY2022/03 (2年目 実績)	FY2023/03 (3年目 実績)	経済的価値 最終年度 (FY2024/03) の 目標 (2022年7月見直し後)
売上高	4,000億円以上	3,203億円	4,118億円	4,608億円	5,000億円以上
営業利益率	15%以上	7.6%	14.9%	16.6%	17%以上
ROE	15%以上	7.9%	19.9%	21.0%	20%以上
営業CF	1,200億円以上 (4カ年累計)	572億円	1,389億円 (2カ年累計)	2,128億円 (3カ年累計)	2,400億円以上 (4カ年累計)
株主還元	連結総還元性向 30%以上	27.7%	30.1%	30.2%	連結総還元性向 30%以上

*上記5項目の数値目標はオーガニック・グロースを前提
*黄色の網掛背景値は当初目標の達成項目

最近のグループニュース (Webサイトより抜粋 : 2023年1月30日~2023年5月10日)

HD

- 「Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター 2023」を受賞 (2023.2.17)
- 「健康経営優良法人2023 ~ホワイト500~」に認定 (2023.3.8)
- 直接描画装置「LeVina」のラインアップを拡充 ~波長375nm対応モデルを7月に発売~ (2023.3.9)
- 信用格付の変更について (2023.3.17)
- 連結子会社の解散に関するお知らせ (2023.3.24)
- 企業理念を改定 (2023.4.12)
- 令和5年度 「知財功労賞 特許庁長官表彰」を初受賞 (2023.4.18)

SPE

- NHKスペシャル「半導体 大競争時代」で当社グループが紹介される (2023.1.30)

GA

- ヒラギノフォント4書体を、フォントサービス「Adobe Fonts」に提供開始 (2023.4.10)

PE

- 大サイズ対応直接描画装置「Ledia 7F-L」を4月に発売 (2023.3.9)

信用格付（長期発行体格付）変更 <株式会社日本格付研究所公表、2023年3月17日>

長期発行体格付

格付の見通し

変更後	A	安定的
変更前	A-	ポジティブ

詳細は[こちら](#)（公式WEBページへ）

■さらなる成長に向け、グループの企業理念改定 <2023年4月12日ニュースリリース>

企業理念

存在意義

人と技術をつなぎ、未来をひらく

未来共有 未来を見つめ社会の期待に誠実にこたえる

人間形成 働く喜びを通じて人をつくる

技術追究 独自技術の追究と融合をすすめる

創業の精神

思考展開 創造と発展に挑み続ける精神

■存在意義の必要性：

自社の存在意義に立ち返り、社内外の誰もが共感し、共に歩んでいける共通の考え方が必要と考え、新たに存在意義を基軸とした企業理念に改定

当社は今後も、新しい価値を提供するソリューションクリエイターとして、すべてのステークホルダーからの信頼と共感が得られるよう、持続可能な社会の実現に貢献していく

ESG関連の取り組み

E（環境）

- 2050年カーボンニュートラルに向けた「カーボンニュートラル宣言」を公表
 - TCFDへの取り組み：当社GA事業、FT事業についてもシナリオ分析などを行い、Webに開示（2023年5月下旬予定）

S（社会）

- 「健康経営優良法人2023 ～ホワイト500～」に認定



G（ガバナンス）

- 取締役会の実効性評価実施
 - 第三者機関によるアンケートを実施。評価結果の概要をWebに近日開示予定



■ 「Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター 2023」を受賞 <2023年2月17日>

株式会社SCREENホールディングスは、特許データの分析から見る世界の革新的な企業・機関トップ100に選出され、「Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター 2023」を受賞。昨年に続いて2回目の受賞となる。

- 「Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター」は世界的な情報サービス企業であるクラリベイト社が保有する特許データを基に、世界の企業・機関の知財動向を分析し、評価される



■ 令和5年度 「知財功労賞 特許庁長官表彰」を初受賞 <2023年4月18日>

株式会社SCREENホールディングスは、経済産業省 特許庁が主催する令和5年度「知財功労賞※」において特許庁長官表彰を初受賞。

※知財功労賞

毎年4月18日の「発明の日」に表彰。

知的財産権制度の発展および普及・啓発に貢献のあった個人に「知的財産権制度関係功労者表彰」、制度を有効に活用し円滑な運営・発展に貢献のあった企業等に「知的財産権制度活用優良企業等表彰」を経済産業大臣および特許庁長官表彰として行われる

大サイズ対応直接描画装置「Ledia 7F-L」を4月に発売 <2023年3月9日>

- プリント基板向け直接描画装置「Lediaシリーズ」の最新機種、大サイズ基板対応高精細モデル「Ledia 7F-L」を発売
- 高精細な描画性能や独自の波長混合技術を踏襲。大サイズ基板においても安定した位置合わせ精度を確保できる高い装置剛性を実現
- 最大661×813mmの基板サイズに対応
- 微細化に伴う高アスペクト比のパターン形成にも対応。メタルマスクなど高細線化が進むさまざまな材料やアプリケーション用途において、高い汎用性を有する



Ledia 7F-L

詳細は[こちら](#)（公式WEBページへ）

>>通信関連やIoTインフラを中心に拡大が続くプリント基板市場でのビジネス展開を加速
>>今後は電子部品分野への製品展開を推進、事業のさらなる拡大を図る

直接描画装置「LeVina」のラインアップを拡充

～露光波長375nm対応モデルを7月に発売～ <2023年3月9日>

- 次世代パターン用直接描画装置「LeVina（レビーナ）」の2 μ m対応モデルを開発（2023年7月から販売を開始）
- 光学系のユニットを刷新、露光波長を375nmとし、世界最高水準となる解像度2 μ mを実現。FOPLP※¹や2.1D/2.3D※²といわれるチップレット※³を実現するための先端半導体パッケージへの活用に期待
- ドライフィルムレジストだけでなく、液状レジストの露光にも対応。
- 従来モデルへの追加・入れ替えで、ラインナップ拡充や改造を可能に。用途に応じたフレキシブルな生産ライン構築に寄与

※1 FOWLPの製造方法を、ウエハーよりも大きなパネルに適用した半導体パッケージ

※2 有機基板表層に有機インターポーザーを一体化させた構造の半導体パッケージ

※3 従来は、1つのチップにCPU/GPU/メモリーなどの機能を詰め込んだSoC（System on Chip）を製造していたが、それぞれ個別に製造した機能別チップをパッケージ内で接続することにより、コストを抑えながら性能を引き上げる技術。

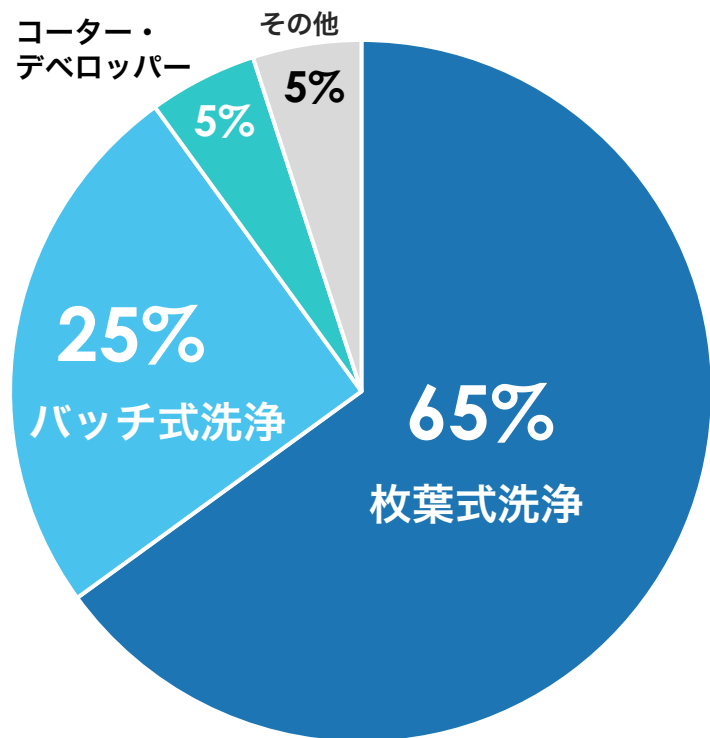


LeVina（2 μ m対応モデル）

詳細は[こちら](#)（公式WEBページへ）

>>5G/ポスト5G関連やIoTインフラを中心に拡大が続くパッケージ基板市場へのビジネス展開を加速
>>半導体パッケージ業界のさまざまなニーズに応え、同業界のさらなる発展に貢献

製品別売上高比率 - FY2023/03 通期



(%)	FY2020/03	FY2021/03	FY2022/03	FY2023/03
枚葉式洗浄	65	70	70	65
枚葉式洗浄のうち、SU-3200の割合	60	65	60	60
バッチ式洗浄	25	25	25	25
コーター・デベロッパー	5	5	5	5
その他	5	0	0	5

※上記比率は、5%刻みの「約」表記

Appendix>> 主要数値の変遷

(億円)	FY2019/03	FY2020/03	FY2021/03	FY2022/03	FY2023/03	FY2024/03 予想
売上高	3,642	3,232	3,203	4,118	4,608	4,950
営業利益	296	125	244	612	764	850
営業利益率 (%)	8.1	3.9	7.6	14.9	16.6	17.2
総資産	3,809	3,479	3,826	4,593	5,628	-
自己資本	1,791	1,739	2,083	2,477	2,998	-
自己資本比率 (%)	47.0	50.0	54.5	53.9	53.3	-
ROE (%)	10.3	2.8	7.9	19.9	21.0	-
減価償却費	68	88	96	95	87	110
設備投資額	240	79	78	134	290	270
研究開発費	228	215	215	240	247	290
EPS (円)	387.10	107.37	325.21	976.55	1,216.33	611.69 ^{※1}
配当金 (円)	97	30	90	293	365	- ^{※2}

※1 FY2024/03の予想EPSは、株式分割の影響を考慮しています

※2 FY2024/03の予想配当金は、株式分割の実施により単純合計できないため非表示。詳細はP28をご参照ください



Innovation for a Sustainable World